

招待券請求(無料)はこちらをクリック!

招待券は1枚につき1名のみ入場可。必ず事前に招待券をご請求ください。

会場案内図 FLOOR MAP

会期 2022年1月19日[水]~21日[金] 10:00~18:00 21日[金]のみ17:00終了
Dates Jan. 19 [Wed] - 21 [Fri], 2022 10:00-18:00 (10:00 - 17:00 on Jan. 21 [Fri])

会場 東京ビッグサイト 東展示棟
Venue Tokyo Big Sight, East Halls

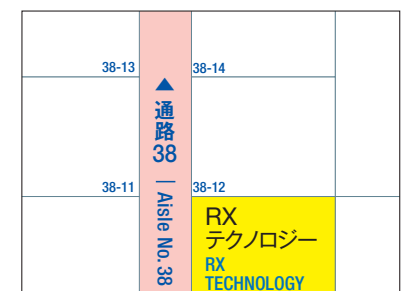
主催 RX Japan株式会社 旧社名: リード エグジビション ジャパン
Organised by RX Japan Ltd. Formerly Reed Exhibitions Japan Ltd.

※2021年12月27日現在、実際のレイアウトと異なる場合がございます。*As of Dec. 27, 2021. The actual layout might be different.

お目当ての会社の探し方 How to search an exhibitor

裏面の出展社一覧で、お目当ての会社の
小間番号を確認してください。

Find out the booth number of
the company you are looking for from
the exhibitors list overleaf.



例/Example 通路番号/Aisle No. 38-10

凡例 Legend



Web版 出展社・製品検索

アクセスは
こちらから

www.nepconjapan.jp/guide/

Search Exhibitors &
Exhibits Online!

Scan the
Code

www.nepconjapan.jp/guide_en/

本展の規模は巨大です。多くの出展社とじっくり商談するために

2日間・3日間の来場をおすすめします



総称: 半導体・センサパッケージング技術展
22nd IC & SENSOR PACKAGING TECHNOLOGY EXPO

総称: プリント配線板 EXPO
22nd PRINTED WIRING BOARDS EXPO

総称: 電子部品・材料 EXPO
22nd ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO

総称: 微細加工 EXPO
12th FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

総称: エレクトロテスト ジャパン
30th ELECTROTEST JAPAN

総称: インターネブコン ジャパン
30th INTERNEPCON JAPAN

ウェアラブル EXPO
ウェアラブル 開発・活用 展
WEARABLE EXPO - WEARABLE DEVICE & TECHNOLOGY EXPO

出展社による
製品・技術セミナー
Exhibitors' Presentation Venue
2

第一実業
DAIICHI JITSUGYO

出展社による
製品・技術セミナー
Exhibitors' Presentation Venue
1

FUJII

出展社による
製品・技術セミナー
Exhibitors' Presentation Venue
2

第一実業
DAIICHI JITSUGYO

出展社による
製品・技術セミナー
Exhibitors' Presentation Venue
1

FUJII